

請求の範囲

- [請求項1] 基材層と、
前記基材層の第1面側に設けられた粘着性樹脂層（A）と、
前記基材層の第2面側に設けられ、かつ、外部刺激により粘着力が低下する粘着性樹脂層（B）と、を備え、
下記の方法1で測定される、試験速度2.5mm/分、試験温度130℃における前記粘着性樹脂層（B）のタック力の積分値（ $F_{2.5}$ ）が1.0gf/秒以上であり、かつ、試験速度30mm/分、試験温度130℃における前記粘着性樹脂層（B）のタック力の積分値（ F_{30} ）が7.0gf/秒以上である粘着性フィルム。
（方法1）タッキング試験機を用いて、プローブ荷重100gf、プローブ押込速度120mm/分の条件で、プローブを前記粘着性樹脂層（B）上に60秒間プレスした後に、試験温度130℃、試験速度2.5mm/分および30mm/分でタック強度（gf）をそれぞれ測定し、横軸に測定時間、縦軸にタック強度（gf）をとり、前記タック強度が0から上昇し始めた点から、再び0になる点までの積分値をそれぞれ算出し、それぞれ前記 $F_{2.5}$ および前記 F_{30} とする。
- [請求項2] 請求項1に記載の粘着性フィルムにおいて、
電子装置の製造工程において封止材により電子部品を封止する際に前記電子部品を仮固定するために用いられる粘着性フィルム。
- [請求項3] 請求項1または2に記載の粘着性フィルムにおいて、
前記粘着性樹脂層（B）は150℃を超える温度で加熱することにより粘着力が低下する粘着性フィルム。
- [請求項4] 請求項3に記載の粘着性フィルムにおいて、
前記粘着性樹脂層（B）が気体発生成分および熱膨張性の微小球から選択される少なくとも一種を含む粘着性フィルム。
- [請求項5] 請求項1乃至4のいずれか一項に記載の粘着性フィルムにおいて、
前記粘着性樹脂層（A）中の気体発生成分および熱膨張性の微小球

から選択される少なくとも一種の含有量が、前記粘着性樹脂層（A）の全体を100質量%としたとき、0.1質量%以下である粘着性フィルム。

[請求項6] 請求項1乃至5のいずれか一項に記載の粘着性フィルムにおいて、前記粘着性樹脂層（A）は（メタ）アクリル系粘着性樹脂を含む粘着性フィルム。

[請求項7] 請求項1乃至6のいずれか一項に記載の粘着性フィルムと、前記粘着性フィルムの前記粘着性樹脂層（A）に貼り付けられた電子部品と、前記粘着性フィルムの前記粘着性樹脂層（B）に貼り付けられた支持基板と、を備える構造体を準備する工程（1）と、
封止材により前記電子部品を封止する工程（2）と、
外部刺激を与えることにより前記粘着性樹脂層（B）の粘着力を低下させて前記構造体から前記支持基板を剥離する工程（3）と、
前記電子部品から前記粘着性フィルムを剥離する工程（4）と、
を少なくとも備える電子装置の製造方法。

[請求項8] 請求項7に記載の電子装置の製造方法において、
前記封止材がエポキシ樹脂系封止材である電子装置の製造方法。